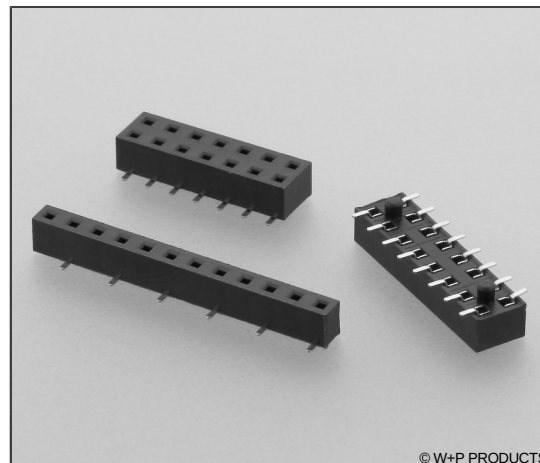


SMT-Buchsenleisten RM 2,54mm, stehend – BH 3,71mm, beidseitig steckbar

SMT Female Headers, 2.54mm Pitch, Vertical – 3.71mm Profile, Dual Entry

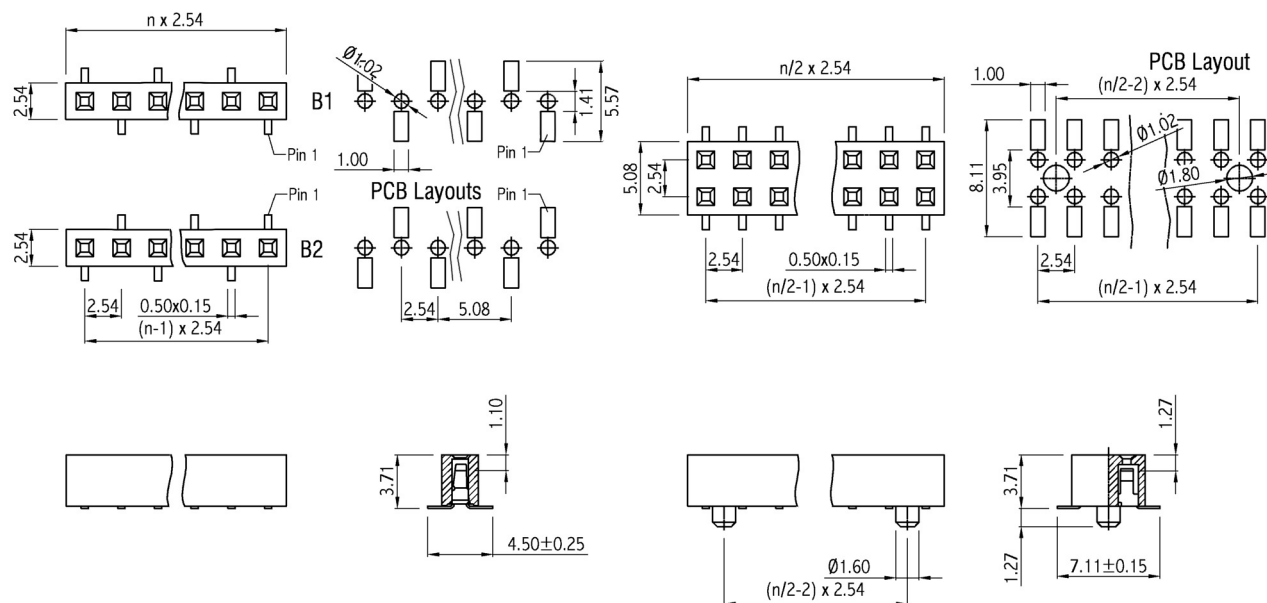
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kontakt für Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	Contact for square pin 0.635mm, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV DC
Test Voltage	1 kV DC
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	250 V AC
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +125 °C
Temperature Range	-40 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für
Vierkantstifte 0,635mm.
Dual beam contacts accept
0.635mm square pins.



Series	Contacts*	Rows*	Plating*	Locating Pegs*	Packaging*
3492	40	3	00	00	ST
	04-40 Einreihig Single row 04-80 Zweireihig Double row	1 Einreihig B1 Single row B1 2 Einreihig B2 Single row B2 3 Zweireihig Double row	00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinnt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex Plating	00 Ohne Pos.hilfen W/o loc. pegs 10 Mit Pos.hilfen (nur zweireihig) With loc. pegs (double row only)	ST PPST PPTR

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads
PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads
PPTR Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

